

ПАКЕТЫ

УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ

Вы можете выбрать наиболее удобный формат участия в международном симпозиуме Асолд 2014. Для этого разработаны два пакета: расширенный и базовый.

| ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ | РАСШИРЕННЫЙ | БАЗОВЫЙ |
|--|---------------|--------------|
| Пленарная часть 22.10.14 | ✓ | ✓ |
| День открытых дверей 23.10.14 | ✓ | |
| Папка участника | ✓ | ✓ |
| Книги 3D-MID* и IPC** | ✓ | |
| Доступ к презентациям для скачивания | ✓ | ✓ |
| Цена пакета участия с НДС, руб. | 12 000 | 7 800 |

* «3D-MID. Материалы, технологии, свойства»: Й. Франке, перевод с английского, под редакцией И. А. Волкова, СПб, ЦОП «Профессия», 2014, 336 с.



** «Технологическая дорожная карта IPC по электронике и радиоэлектронике»: перевод с английского – ООО «ЦТИ ПЭ», под редакцией А. А. Большакова, Москва, Техносфера, 2014, 664 с.



20%

скидка оплатившим участие
до 13 октября

Регистрируйтесь на сайте
www.asold.ru
или по тел.:
+7 (495) 212-16-98